

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>				
	参与单位名称 及 人员姓名	机构名称	姓名	机构名称	姓名
		施罗德	Chris Yim	上银基金	徐一丹
		华夏基金	史琰鹏	西部自营	陈曦
		易方达	刘健维	西部自营	李远剑
		银华基金	吴文蔚	西部自营	庄自超
		招商基金	孟焱毅	人寿资产	李宗燃
		招商基金	陈西中	人寿资产	陈子龙
		富国基金	方竹静	博道基金	钟婷霞
		富国基金	于晴	高毅资产	罗晓迪
		富国基金	李娜	中欧基金	王卓立
		交银基金	郭斐	国寿养老	郭琳
		博时基金	符昌铨	圆信永丰	田玉铎
		盘京投资	王莉	诺安基金	黄友文
		太平资产	张浩	中信资管	赵兵兵
		宏利基金	刘晓晨	华富基金	姚明昊
		鹏华基金	孟昊	友邦保险	黄怿炜
		华商基金	蒋捷	中庚基金	陆伟成
		天弘基金	张磊	泉果基金	王苏欣
		工银瑞信	李乾宁	泰康基金	翟一柠
		宝盈基金	倪也	中信资管	曹苍剑
		泰康资产	余思雨	永赢基金	焦鼎
		方正证券	王海维	泰康资产	鲍亮
		泰康资产	陈佳艺	泰康资产	王栋
		泰康资产	曹令	泰康资产	王成
		泰康资产	张欣星	泰康香港	陈杨
		富国基金	王卓立	富国基金	范妍

	富国基金	赵伟	富国基金	胡怀瑾
	富国基金	王昭光	富国基金	顾飞飞
	富国基金	汤启	富国基金	肖威兵
	富国基金	李元博	富国基金	方竹静
	富国基金	毕天宇	富国基金	闫伟
	富国基金	朱少醒	富国基金	孙萌
	华安基金	翁启森	华安基金	孔涛
	华安基金	舒灏	华安基金	金拓
	华安基金	吴秋一	华安基金	栾超
	华安基金	曹一凡	华安基金	王春
	华安基金	饶晓鹏	华安基金	刘潇
	易方达	刘展硕	易方达	于博
	易方达	黄鹤林	华泰证券	汤仕翥
	华泰证券	张婉滢	富国基金	方竹静
	安联基金	薛辉蓉	富国基金	王卓立
	从容投资	胡庶	合远基金	庄琰
	上海自营	张胡学	海创基金	李智琪
	玄元投资	谢智莲	杭银理财	薛翔
	中泰证券	洪嘉琳	国联基金	周昊
	国联基金	梁勤之	国联基金	甘传琦
	国联基金	潘天奇	国联基金	吴刚
	开源证券	李睿娴	开源证券	初敏
	国海证券	高力洋	摩根士丹利	周子涵
	开源证券	陈凯	民生加银	夏荣尧
	民生加银	郑爱刚	民生加银	范明月
	民生加银	尹涛	民生加银	朱于叡
<b>时间</b>	2026年6月1日-30日			
<b>地点</b>	扬州扬杰电子科技股份有限公司会议室			
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长 梁勤女士 副董事长 梁瑶先生 董事会秘书 秦楠女士 证券投资部 陈逸妍			
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	一、介绍公司概况及业绩情况 公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品主要分为三大板块，具体包括材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5吋、6吋、8吋硅基及6吋碳化硅等各类电力电子器件芯片）及封装器件板块（MOSFET、IGBT、			

SiC 系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列)。产品广泛应用于汽车电子、人工智能、清洁能源、工业、消费类电子等诸多领域,为客户提供一站式产品、技术、服务解决方案。

## 二、问答环节

Q: 请介绍经营情况,如目前产品交期、在手订单情况、产能情况等。

A: 现阶段公司经营整体稳健,整体产销态势良好,各产线持续满负荷运行,设备稼动率始终维持在较高水平。订单需求保持饱满,支撑产能高效释放,目前整体交周期对比前期有所拉长。产能建设方面,部分产线如杰楚微 8 吋、小信号、SiC 等产线正按既定规划稳步推进扩产工作;其余产线则结合在手订单与市场需求,采用以销定产的模式灵活规划产能扩充,保障供需匹配。

Q: 请介绍公司变更募投项目的原因。

A: “发展功率元件业务,包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目结项原因:截至目前,公司越南工厂一期已实现满产,现有产能具备一定的海外订单交付能力,海外产能布局已达到阶段性规划目标。公司原计划持续推进海外实体产能建设,但结合当前实际情况:一方面,新能源汽车与 AI 基础设施领域市场快速发展、市场规模持续扩张,叠加国家产业政策扶持,市场发展窗口期宝贵,这亦是公司补齐高端产能、切入高附加值赛道、巩固行业地位、抢抓发展机遇的关键所在,而越南工厂现有产能已能够满足阶段性海外业务需求,相较继续投入海外产能建设,境内项目落地实施的现实必要性与时间紧迫性更为突出;另一方面,鉴于全球贸易环境复杂多变,海外投资面临的不确定性 & 风险溢价显著上升,大规模增加海外产能建设的外部环境较项目立项时已发生较大变化。

“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项原因:目前,公司已通过自有资金将海外研发中心、渠道布局到位,已具备支撑当前国际业务运营的基本能力,现有海外布局可满足现阶段业务需求。当前,全球经济格局深度调整,国际产业资源配置面临新的不确定性,地区技术保护壁垒显著提高,部分

国家和地区对半导体领域的技术投资与贸易实施了更为审慎的监管政策，跨境投资与科技合作的不确定性及合规风险增加。与此同时，以人工智能、汽车电子、工业控制及新能源为代表的重点领域呈现结构性增长机遇，对核心工艺、先进设备、产品性能、可靠性和供应链响应速度提出了更高要求。

因此，基于审慎投资原则及对投资者负责的态度，为进一步提升募集资金使用效率，保障募集资金安全、合理运用，结合公司当前发展规划及业务布局优化需要，公司决定变更募投项目的募集资金用途，并将剩余募集资金投向效益更优、更契合公司长远战略发展方向的项目建设。

Q：请介绍公司变更募投项目后续规划。

A：新募投项目为：

1. 车规级功率半导体模块封装项目：当前全球新能源汽车产业处于爆发式增长周期，整车及零部件技术不断迭代升级，车辆的性能、安全性、可靠性要求不断提高，对车规级功率半导体形成巨大刚性需求。本项目建成投产后，将直接匹配新能源汽车行业对 IGBT 模块、MOSFET 等关键功率器件的迫切需求，加速新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）核心部件的国产化替代进程，特别是在车载充电器（OBC）、电机控制器（MCU）、DCDC 转换器等核心场景中，项目产品具备耐高温、抗电磁干扰等优良性能，能够助力新能源汽车关键性能指标的提升及技术的进步。

2. AI 基础设施用功率器件生产线技术改造项目：对小信号功率半导体生产线进行技术改造，生产 AI 基础设施用高性能小信号功率半导体器件，能够有效替代进口，为下游企业提供高质量、高可靠性的小信号产品。

Q：请介绍公司面向 AI 数据中心领域配套供应的相关产品情况。

A：公司面向 AI 数据中心场景供应 SiC、MOSFET、小信号、整流器件、保护器件等多系列功率半导体产品，各品类均保持稳定批量供货。依托成熟的技术储备与自有工艺制造平台，公司可结合下游不同应用工况及客户个性化诉求，提供一站式定制化产品与系统解决方案，匹配实际应用要求，持续深化长期稳定的合作关系。

Q: 请介绍欧盟豁免的情况。

A: 在欧洲汽车行业客户的呼吁之下，欧盟理事会于当地时间 2026 年 6 月 15 日发布了决议 (CFSP) 2026/1333，根据该决议，在《第 2014/145/CFSP 号决定》第二条中新增了有限豁免条款，公司获得了欧盟理事会九个月豁免期。具体豁免情况包括：1、在 2026 年 12 月 31 日前，与公司在 2026 年 4 月 23 日前订立的业务、合同或其他协议可以继续开展；资金或经济资源的解封或提供应于 2026 年 12 月 31 日前完成；或 2、为确保欧盟经营者的供应链多元化，于 2027 年 3 月 16 日前，产业可以向公司采购其生产的关键零部件并向公司支付相应款项。

后续，公司将密切关注相关事项的进展，积极协调内外部专业资源，加快推进政移除程序及法律诉讼准备工作，力争通过合法合规途径推动公司从制裁名单中移除，切实维护上市公司及广大投资者的合法权益。

Q: 请介绍公司涨价情况。

A: 受行业大环境影响，近年来上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线持续涨价，为对冲成本压力，我司上半年已全力推进工艺优化、供应链管控精益运营等全方位降本举措，全力消化成本增量，最大限度维持原有供货单价，尽力分担客户采购压力。步入下半年，原材料再度迎来新一轮大幅涨价周期，成本增幅超出预期，企业生产经营承压加剧。为保障产品品质稳定、确保供应链可持续交付，经审慎研究评估，我司决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为 10%-15%，新价格自 2026 年 7 月 1 日起出货正式执行。

Q: 请介绍目前 SiC 业务的情况。

A: 公司 SiC 业务目前在手订单饱满，产销维持良好态势，产能利用率处于高位。为匹配市场需求，公司正同步推进产能扩建，夯实交付能力。公司实行车规与非车规产品严格分线管理，配备深耕车载领域的研发生产团队，搭建完善车规级管控体系，同时建有 CNAS 认证实验室，产品可靠性验证能力齐全。目前拥有 1 座 SiC 车规晶圆工厂和 3 座 SiC 车载产品封测工厂，搭建一体化智慧工厂数字化质量管控平台，完成生产、设备、品质、供应链全流程自动化实时监控。SiC 产品规格覆

	<p>盖齐全，可广泛应用于新能源汽车、光伏储能、工业工控、AI 服务器电源及消费类电源等多下游领域。</p> <p>Q: 请介绍公司最新推出的 40A 1500V 高压 PTC 芯片产品。</p> <p>A: 伴随新能源汽车价格竞争日趋激烈，800V 高压平台电车正持续向 20 万元以下的中低端市场渗透,由此带动高压平台 PTC 产品方案的需求显著增长。基于对 800V 高压平台向中低端车型渗透趋势与 PTC 应用痛点的深刻洞察，公司定制化开发了 40A 1500V 高压 PTC 系列产品，在车规可靠性、电压应力与综合成本之间达成最优平衡。该系列产品以 T0-247-3L/4L 双封装方案、1900V 以上实测击穿电压、10 <math>\mu</math>s 短路耐受能力等硬核指标，精准填补了当前高压芯片方案的市场空白。目前，首批 168h 车规可靠性验证已顺利通过，产品已具备送样条件。</p> <p>Q: 请介绍公司斩获 CSPSD 2026 优秀技术创新产品奖的 1200V SiC MOSFET 产品。</p> <p>A: 这款专为新能源汽车 OBC 场景定制的产品于 2025 年 12 月正式推出，实现性能双重突破：在保障通态损耗对标行业顶尖水平的同时，大幅优化开关特性，可有效助力车载充电系统实现高效、节能、低噪、小型化升级。同时具备高耐压、强抗干扰、高雪崩能量、优异抗短路能力，全维度通过严苛车规级验证，可靠性适配车载复杂工况。目前该产品已实现规模化量产落地，并成功导入国内主流 OEM 核心 Tier1 供应链，广泛应用于 400V/800V 平台 6.6kW/11kW OBC 系统；同时成功配套日系品牌 800V 高压平台 11kW/22kW 高功率 OBC 项目，以国产化 SiC 解决方案打破海外垄断。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 1 日